芯片景气跟踪系列：海外厂商MCU、模拟、分立器件交期持续保持高位

投资要点：

海外厂商 MCU 和 FPGA 交期继续拉长。我们根据全球电子元器件代理公司富昌电子发布的市场行情报告进行了各类元器件的历史交期梳理。目前海外 MCU 产品交货保持紧张，其中汽车 MCU 紧张程度更严重，预计将加速国产厂商产品的导入。

对于 FPGA 产品，海外厂商的交期从 22Q1 开始进一步拉长，显示海外大厂的 FPGA 供应仍未见好转。

模拟器件保持供应紧张。整体来看，模拟器件的交期趋势也是在进一步拉长。具体来看，汽车模拟和电源产品交期全部在 40 周以上，在各类产品中紧张程度较高。

此外，开关稳压器、信号链芯片交期也不容乐观。由于模拟器件大多在成熟制程上生产，且目前成熟制程晶圆产线扩产受到设备交期长等因素影响，预计模拟器件仍将保持供应紧张的状态。

IGBT、MOSFET 和 SiC 器件交期保持高位，扬杰海外品牌 MCC 交期较好。分产品品类来看，IGBT 产品各厂商均供应紧张，且在 22Q1 紧张程度有加剧。海外 MOSFET 假期保持紧张，但是 MCC 品牌（扬杰科技子公司）交期较好，较为稳定。受益于电动车和新能源对第三代半导体需求的提升，SiC/GaNMOSFET 交期也保持在 42 周以上。其他的分立器件，如 ESD、SBD、TVS、晶闸管，供应略紧张，但交期比一些高压器件要好。总

https://www.yunbaogao.cn

体来看，分立器件受益于电动车、新能源等需求的提升，海外大厂供应情况也没有改善。扬杰科技海外的 MCC 品牌目前交期较好，预计能在海外产品交期较长背景下抢夺一些市场。

存储产品整体交期稳定，EEPROM 海外大厂供应紧张。在存储器产品中，NOR 闪存整体交期稳定，只有部分厂商的产品交期较长；NAND 闪存产品交期也适中；DRAM 和 SRAM 整体交期稳定。EEPROM 产品交期较高，其中 ST、Microchip 的产品交期在 52 周以上。

电解电容交货紧张，MLCC 交期趋势平稳。在被动元器件中，我们统计了 8 大类 43 款产品的历史交期和最新变化。整体来看，交期在高位的品类包括：薄膜电容（头部厂商）、电解电容、滤波器、固定电阻器，交期适中的品类包括：MLCC、超级电容、电感、钽电容。受益于下游新能源需求的拉动、原材料成本的上升，薄膜电容和电解电容交期自 21Q3 开始拉长，且部分电解电容产品在 22Q1 的交期进一步上升。MLCC 产品呈现高容供需较低容紧张的局面。高容 MLCC（1uF 以上）目前交期在 20~30 周，而低容 MLCC 交期在 20 周左右，不过车规级 MLCC 交期仍偏长。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_41682